

2024年 台股投資展望

- 隨著美國通膨持續降溫，市場預期最快2024年3月Fed有望開啟降息循環，讓美國公債殖利率下滑，帶動股市評價回升
- 展望2024年，在AI放量及半導體復甦的情況下，台股基本面有撐，且外資亦有望持續回補，皆有助支撐台股長期向上走勢

2023/12

2024年台股展望

AI放量加上半導體景氣復甦，及部分傳產族群獲利上修，族群遍地開花

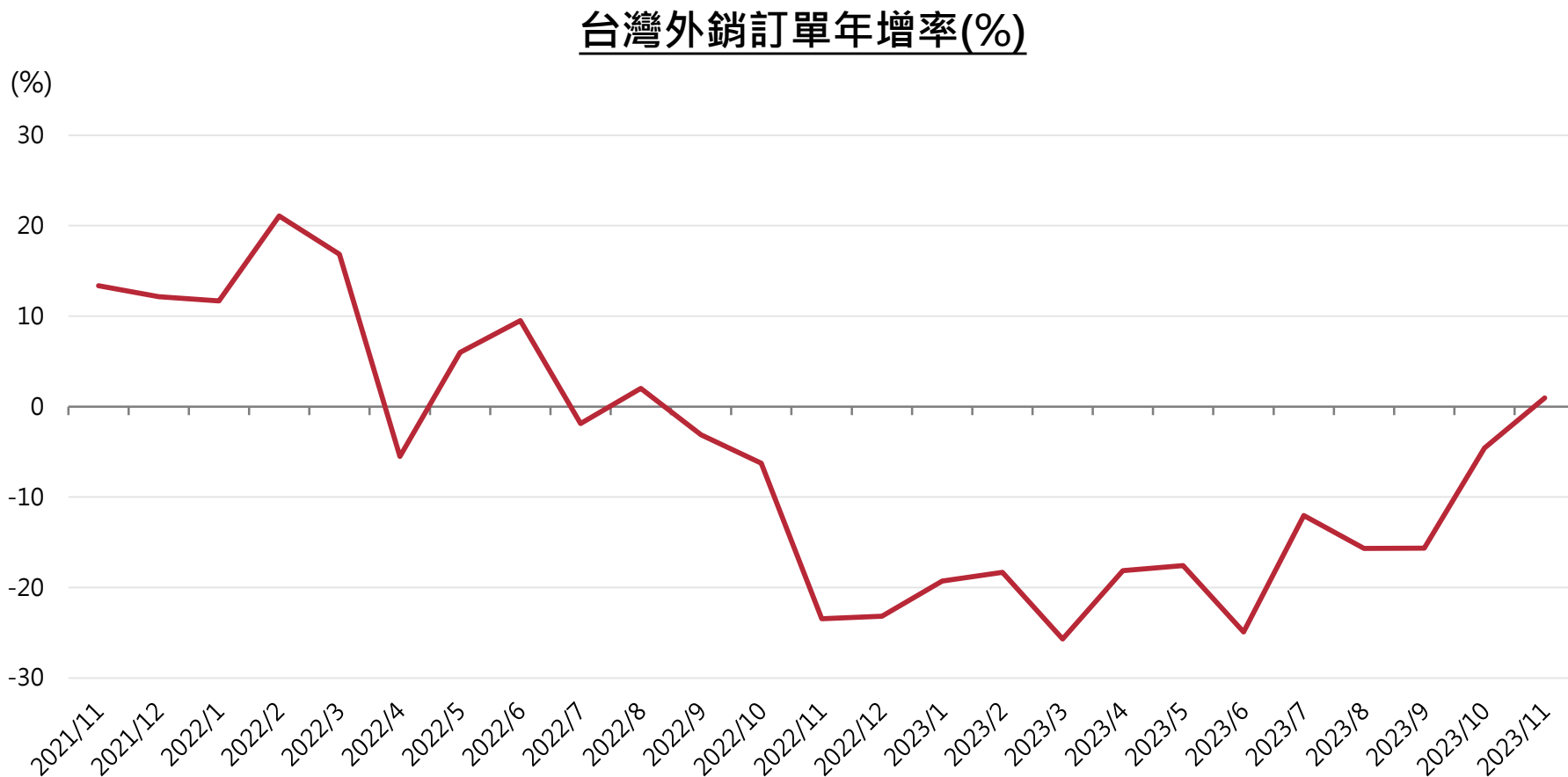
- AI成長趨勢明確，AI手機及PC將成為後續焦點，應用層面擴大；半導體庫存已調整至健康水位、景氣逐季復甦，有利AI及半導體營收獲利動能，包含晶圓代工、IC設計、記憶體、封測及矽晶圓等產業皆將受惠
- 傳產部分，重電將持續成長，其他包括鋼鐵、紡織、鞋業、工具機等可望谷底回升，企業獲利將進入上修循環，有利股市評價提升
- 隨著美國通膨持續降溫，預期最快2024年3月Fed有望降息，支持股市評價回升。展望2024年，在AI放量及半導體復甦的情況下，台股基本面有撐，且外資有望持續回補，皆有助台股震盪走高

類股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形。資料來源：復華投信整理，2023/12

台灣外銷訂單恢復正成長，景氣有望落底改善

2024年看好AI商機持續，推動台灣電子產品外銷動能

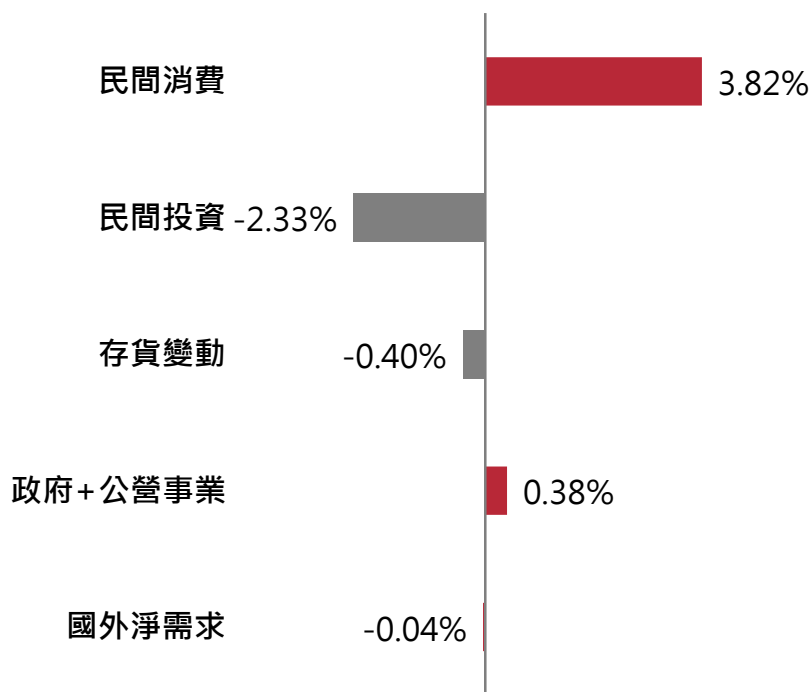


2024年台灣經濟成長預期轉佳

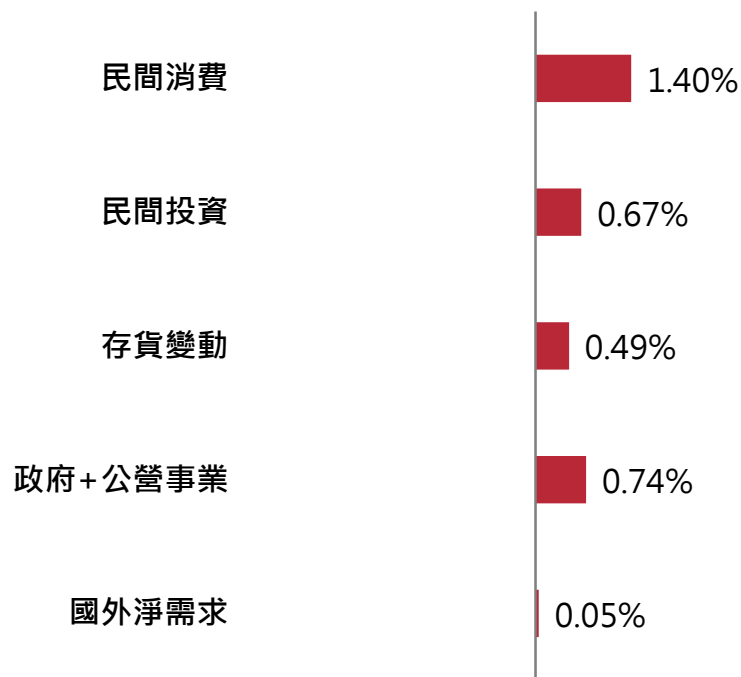
全球需求回溫，將推升台灣廠商投資及訂單增加

主計處預測台灣GDP，及各分項對GDP之貢獻

2023年預估GDP年增率 **1.42%**



2024年預估GDP年增率 **3.35%**



市場預期Fed在2024年第二季左右開始降息(3月或5月)

若經濟加速放緩或有衰退風險，Fed可能提前做預防性降息

利率期貨市場預期的升降息機率

Fed Funds Rate FOMC會議日期	4.25 - 4.50% (累積降息四碼)	4.50 - 4.75% (累積降息三碼)	4.75 - 5.00% (累積降息二碼)	5.00 - 5.25% (累積降息一碼)	5.25 - 5.50% (維持目前利率)
2024/1/31	0%	0%	0%	18%	82%
2024/3/20	0%	0%	14%	68%	19%
2024/5/1	0%	13%	65%	21%	0.8%
2024/6/12	18%	61%	19%	0.7%	0%
2024/7/31	57%	23%	2%	0.1%	0%
2024/9/18	26%	4%	0.3%	0%	0%

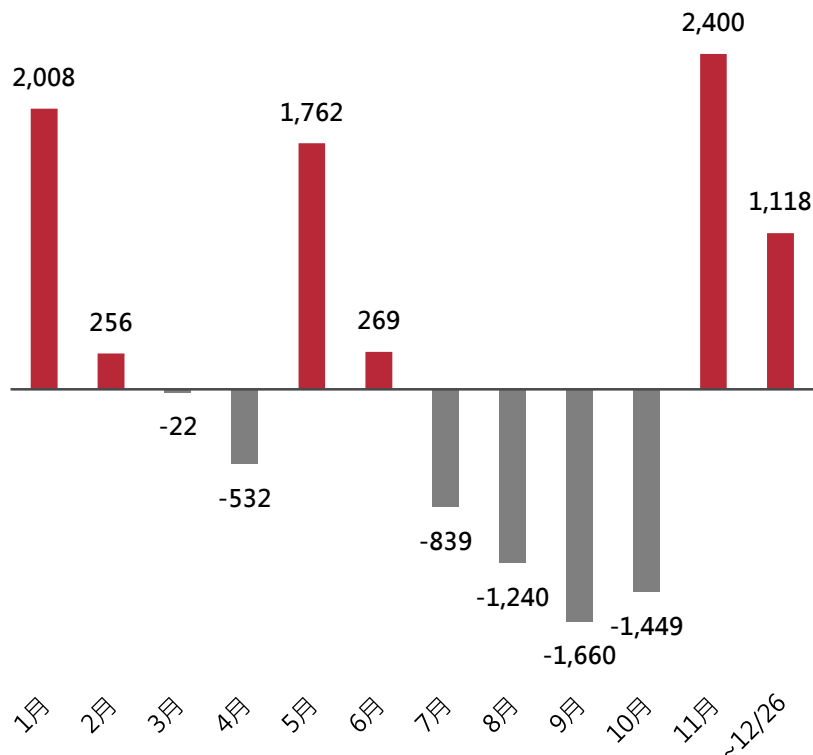
上述各次會議之降息機率，若合計未達100%，表示市場預期利率將降至4.25%以下

過往Fed結束升息至降息期間，股市易有資金行情

2023年11月市場鴿派解讀FOMC會議+台股基本面有撐，外資開始歸隊

2023年各月份外資買賣超台股金額

(新台幣·億元)



過往Fed結束升息至首度降息的台股表現

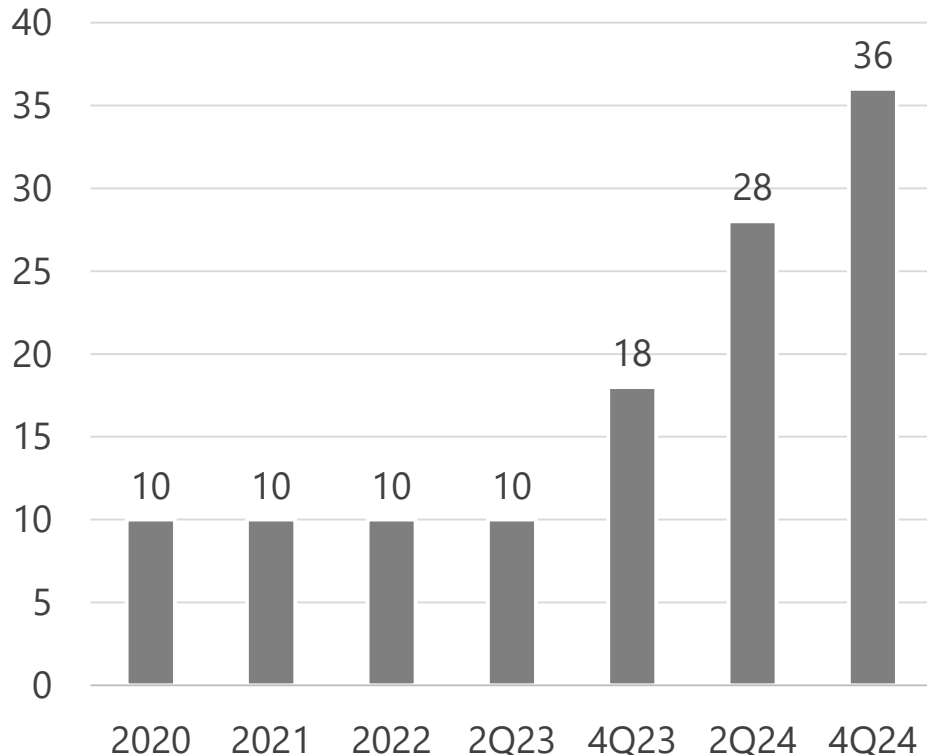
Fed最後一次升息日	Fed首次降息日	台灣加權股價指數報酬率
2000/5/16	2001/1/3	-43.92% (因網路泡沫)
2006/6/29	2007/9/18	34.70%
2018/12/19	2019/7/31	10.64%
2023/7/26 (最近一次升息)	??	3.43% (最近一次升息 ~2023/12/26)

CoWoS產能將於2024年第二季大量開出， 有利AI供應鏈營運動能

AI供應鏈股價可望提前於2024年第一季轉強

CoWoS產能狀況

(千片/月)



CoWoS

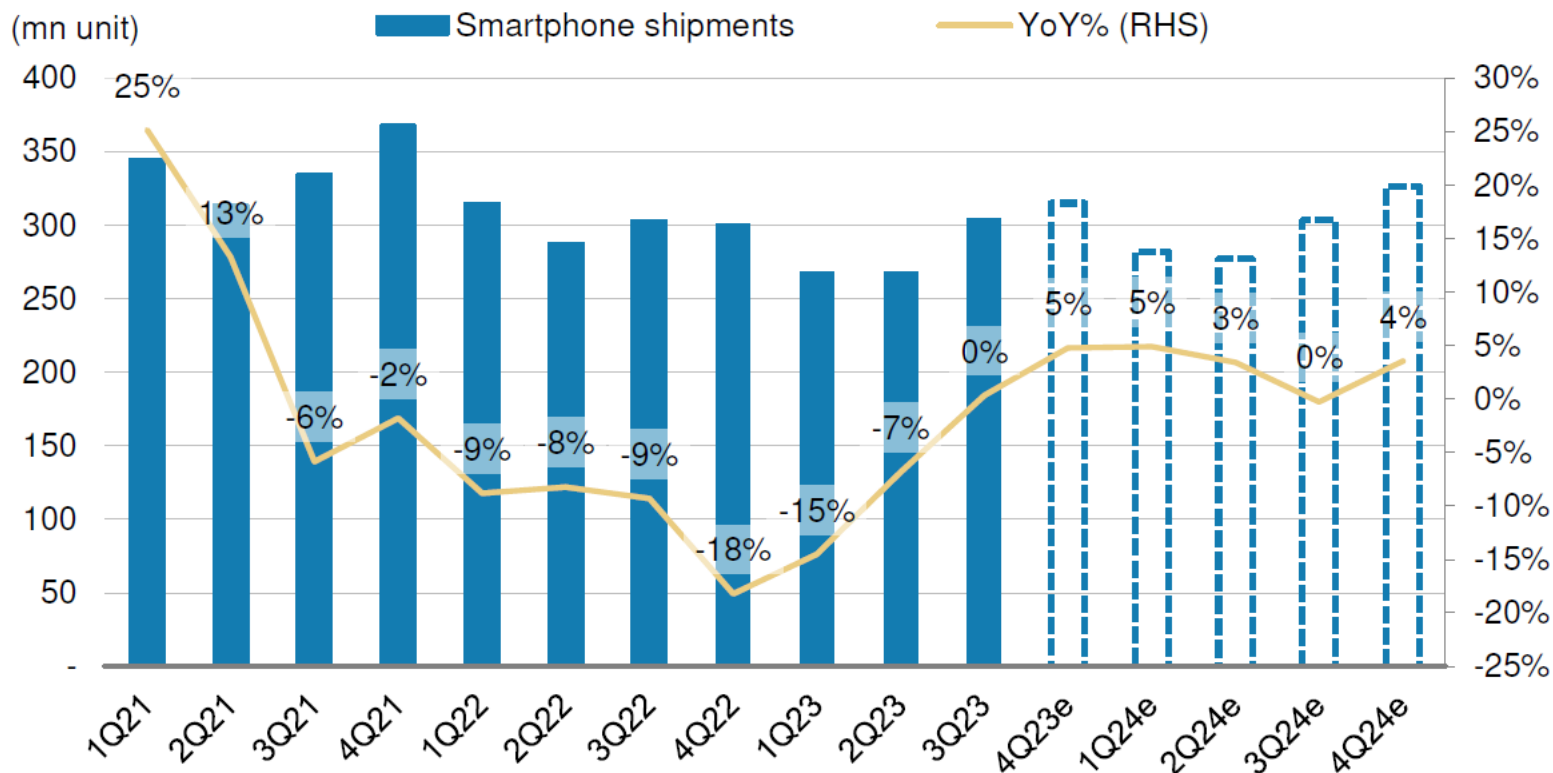
(Chip-on-Wafer-on-Substrate)

- 將晶片堆疊起來，並封裝在基板上的一種封裝技術，好處是可減少晶片的空間，並減少功耗與成本。
- CoWoS 應用領域廣泛，包含高效能運算、AI 人工智能、數據中心、5G、物聯網、車用電子等等，在未來的各大趨勢，CoWoS 封裝技術都會扮演著相當重要的地位。

手機於2024年將恢復正成長

預期後續AI手機將更可刺激換機潮或更多裝置需求

Morgan Stanley 預測手機出貨量



2024年PC需求有望回升

受惠換機潮及AI導入PC商機，帶動PC成長動能

PC相關供應鏈積極導入AI PC

晶片廠

英特爾、高通、聯發科、超微

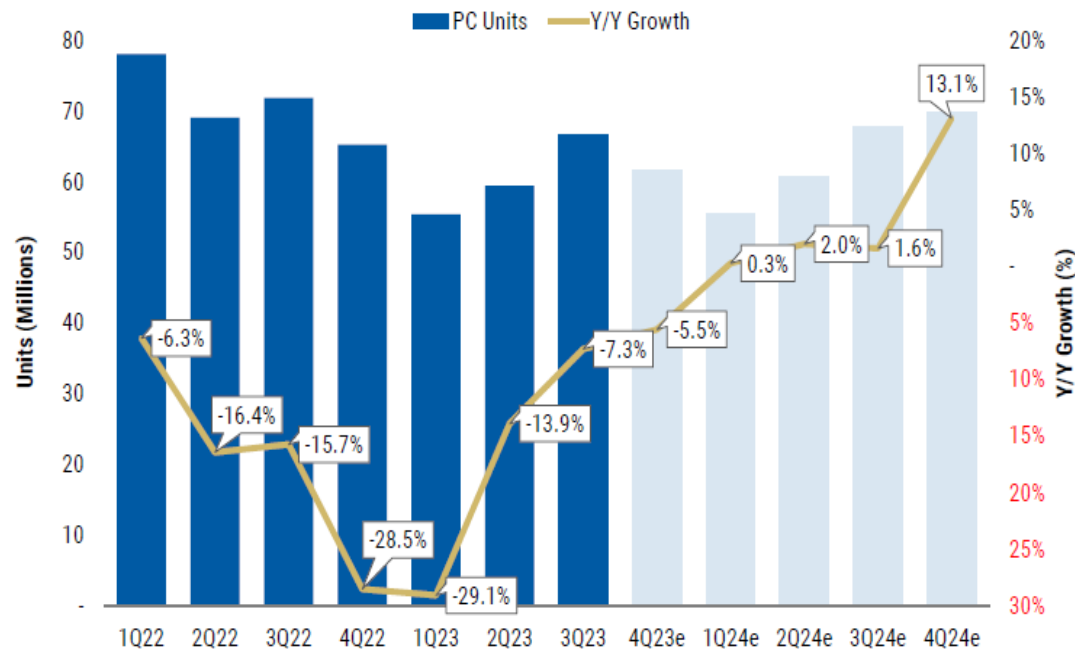
品牌廠

聯想、HP、Dell、宏碁、華碩

作業系統

微軟

Morgan Stanley 預測PC出貨量



個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形。資料來源：Morgan Stanley Research

半導體產業應已開始進入新的擴張循環

半導體產業銷售金額及增速皆已見底，並開始向上

全球半導體銷售金額及未來可能走勢



半導體產業成長動能

AI、車用、工控、資料中心

半導體各項應用展望

Semiconductor Market Outlook by Application



晶圓代工利用率有望觸底回升

2023下半年復甦力道平淡，但預期2024年可望有較明顯回升

全球晶圓代工利用率預測走勢

WW Foundry Average Utilization Rate Forecast

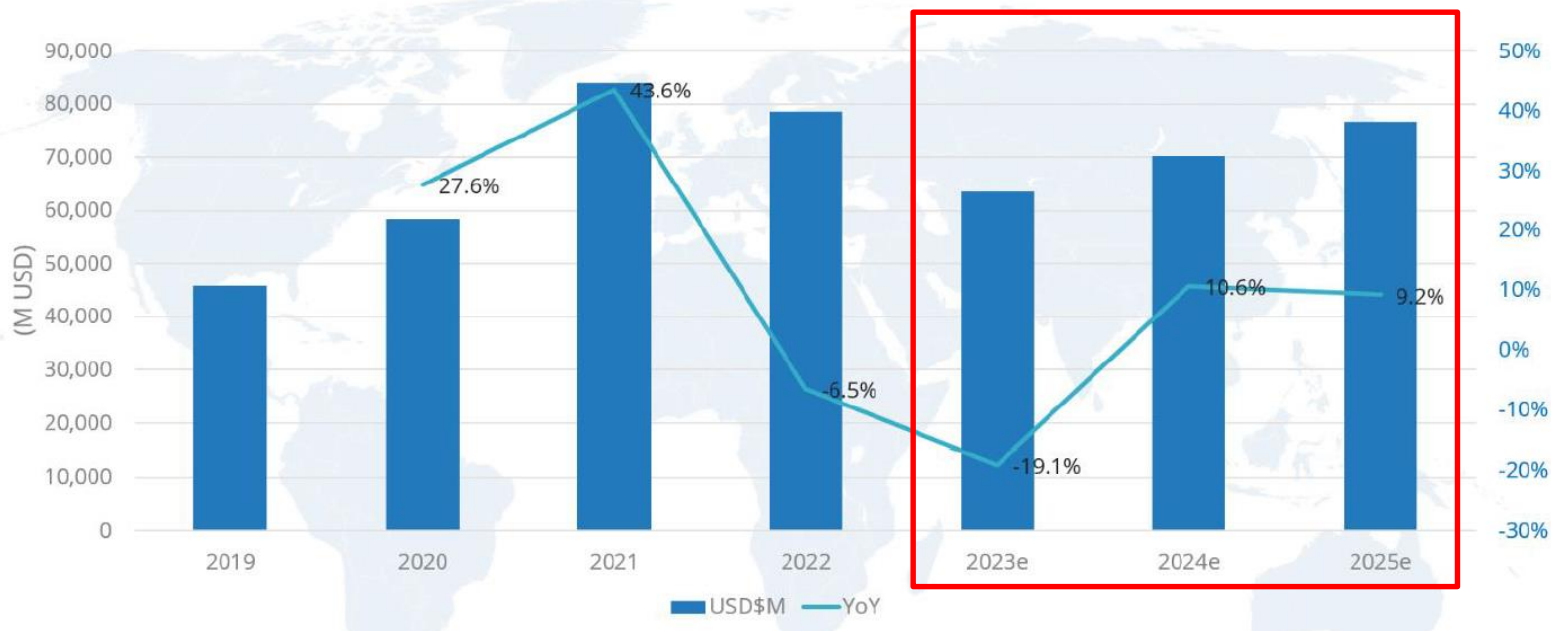


亞太區域的IC設計將於2024年重回成長趨勢

AI PC及AI手機趨勢，預期對台灣IC設計公司將為利多

亞太區的IC設計市場規模預測走勢

Asia/Pacific Fabless Market Forecast



台股半導體類股評價相對較低，後續仍有表現空間

台灣半導體類股2023年漲幅相對落後全球半導體類股

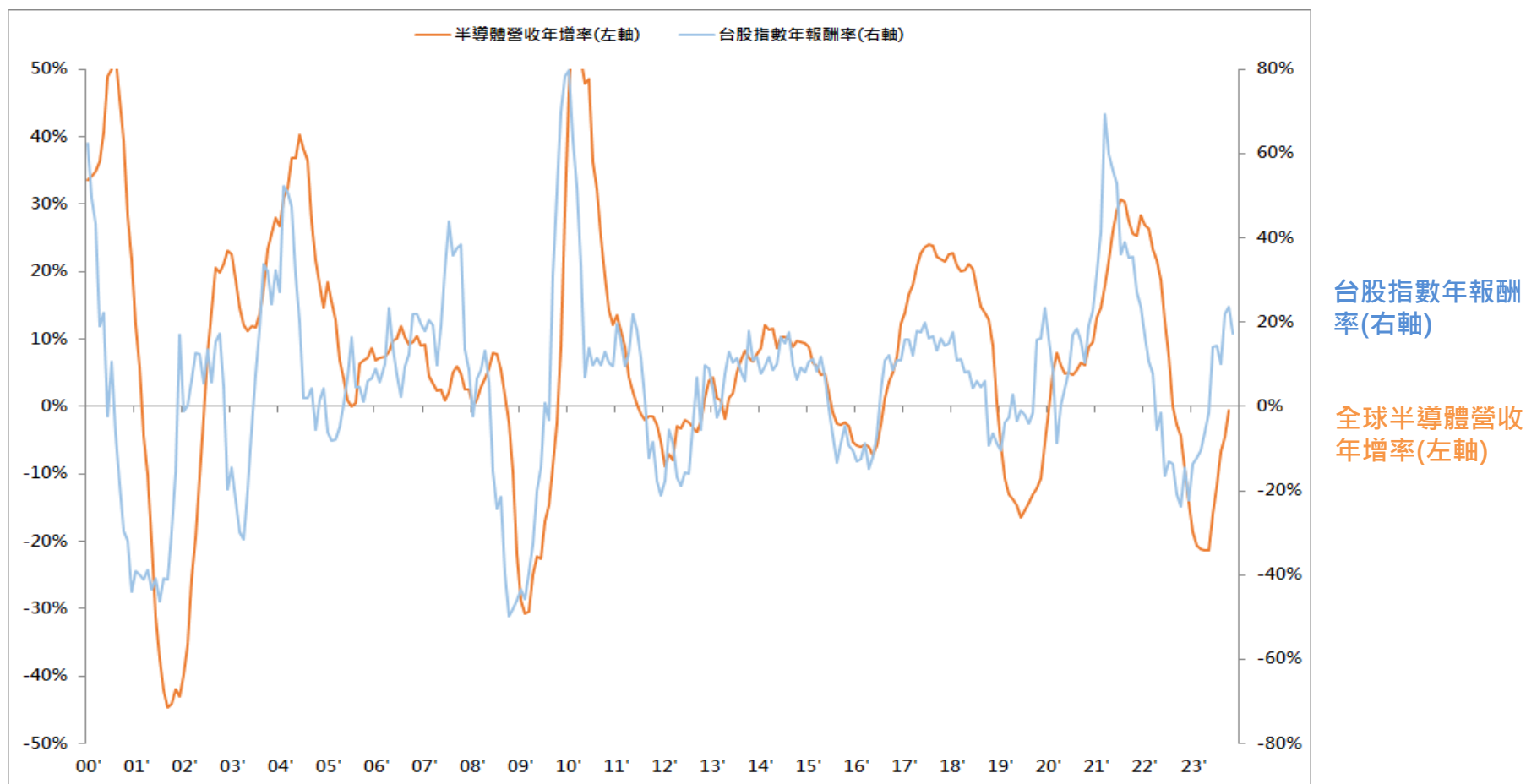
台灣相對全球半導體類股本益比走勢圖



半導體景氣位於初期復甦階段，台股仍有續漲空間

全球半導體營收年增率才剛開始谷底復甦

全球半導體營收年增率、台股指數年報酬率



AI趨勢+半導體復甦，有望推動台股向上

2024年台灣企業獲利轉為雙位數成長，且股市評價處偏區間中下水準

主要國家股市	2023年企業獲利 成長率預估(%)	2024年企業獲利 成長率預估(%)	2023年 預估本益比	2024年 預估本益比	過去5年 本益比區間
MSCI全球指數	+0.1	+10.3	18.4	16.6	12.6~24.5
台灣加權股價指數	-22.1	+19.0	18.4	15.6	9.1~20.3

台股的可能表現

2023Q4下旬~2024Q2

- Fed確立停止升息
- 半導體基本面開始改善，回補庫存
- AI供應鏈訂單持續放量增加
- 3月若降息可能因利多出盡而短期漲多休息

2024Q2下旬~2024Q4

- 降息循環啟動讓股市評價提升
- 半導體市況明顯回升
- AI供應鏈營運動能增強
- 一般server與車用訂單動能轉強
- 企業開始上修獲利預估

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。

復華證券投資信託股份有限公司

10492台北市八德路二段308號8樓
8F, No. 308, Sec 2, Bade Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C

0800-005-168

台北 T 886-2-8161-6800
桃園 T 886-3-316-8310

復華金管家 

台中 T 886-4-2254-2788
高雄 T 886-7-535-7068